



平成27年4月30日

各 位

会社名 株式会社テラプローブ
代表者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
(コード番号：6627) 東証マザーズ
問合せ先 執行役員 CFO 神戸 一仁
(TEL 045-476-5711)

包括契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、Micron Technology, Inc. (以下「MT I社」) 及びマイクロンメモリ ジャパン株式会社 (以下「MM J社」) と包括契約を締結することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 契約の背景

当社は半導体製品のテスト受託 (以下「ウエハテスト」) を主な事業としております。特にMM J社向けの売上高は当社連結売上高の約50%を占める重要な取引となっております。このMM J社向けテストサービスに関する“ウエハテスト委託に関する基本合意” (平成22年4月28日締結) が平成27年2月28日に契約期限を迎えることなどから、契約を延長しつつMT I社及びMM J社と当社は協議を重ねてまいりました。この結果、平成27年5月1日付で3年間の包括契約を3社で締結することとなりました。

2. 契約の概要

- 平成22年4月28日締結の“ウエハテスト委託に関する基本合意” および平成17年10月1日締結の“開発委託基本契約” は平成27年6月1日をもって終了する。
- 当社は、MM J社が新たに導入するMT I社製テストを使用して、MM J社にテストサービスを提供する。
- 当社は、当社が導入している既存テストを使用して、MM J社にテストサービスを継続して提供する。
- MM J社は、MM J社「Fab15 (広島工場)」の生産量の実質全量について、そのウエハテストを当社に委託する。

3. 契約先の概要

(1)	名称	マイクロンメモリ ジャパン株式会社
(2)	主な事業	半導体の開発、設計、製造、販売
(3)	設立年月	平成11年12月
(4)	本店所在地	東京都中央区八重洲二丁目2番1号
(5)	代表者	代表取締役 木下 嘉隆
(6)	資本の額	30,000百万円

(1)	名称	Micron Technology, Inc.
(2)	主な事業	半導体の開発、設計、製造、販売
(3)	設立年月	昭和53年10月
(4)	本店所在地	8000 S. Federal Way, Boise, Idaho, アメリカ合衆国
(5)	代表者	CEO D. Mark Durcan
(6)	資本の額	108百万米ドル

4. 今後の見通し

本契約の影響も含め、平成 28 年 3 月期第 1 四半期の業績見通しは、現在精査中であり、平成 27 年 5 月 15 日の平成 27 年 3 月期決算短信発表時に開示する予定です。

以 上